

LCP 日本宝理 E463I-BK210P连接器专用LCP塑胶原料更多信息

产品名称	LCP 日本宝理 E463I-BK210P连接器专用LCP塑胶原料更多信息
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

LCP塑胶原料还可以与聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金，制件成型后其机械强度高，用以代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料，既可提高机械强度性能，又可提高使用强度及化学稳定性等。目前正在研究将LCP用于宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统等。

LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP塑胶原料是防火安全性好的特种塑料之一。

LCP塑胶原料密度为1.4~1.7g/cm³。液晶聚合物具有高强度，高模量的力学性能，由于其结构特点而具有自增强性，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平；如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

用液晶作成的纤维可以做鱼网、防弹服、体育用品、刹车片、光导纤维几显示材料等，还可制成薄膜，用于软质印刷线路、食品包装等。

PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

PP塑胶原料比水还轻，因此其制品自然很轻巧，另外，多数塑料还有美观大方的外观，如光亮、透明等，更兼塑胶原料着色容易，可使制品具有各种绚丽多彩的颜色，使得制品大受人们欢迎。

POM具有明显的熔点，均聚POM为175、共聚POM为165。成型时，料筒温度的分布：前段190~200，中段180~190，后段150~180，喷嘴温度为170~180。对于薄壁制品，料筒温度可适当提高些，但不能超过210。

COC具有与PMMA相匹敌的光学性能以及具有高于PC的耐热性,还具有比PMMA和PC更加优良的尺寸稳定性等.COC还具有改善水蒸汽气密性,增加刚性耐热性,易赋予切割性能等优点.

由于拥有的粘合持久性和食品卫生性,在食品包装领域赢得了广大客户的信赖。由于引入的官能团的作用,针对聚烯烃的颜料、木粉等多种填料,Admer也可以起到偶联剂的效果,增加这些填料与聚烯烃的相容性。

模具温度通常控制在80~100℃,对薄壁长流程

一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;

9T塑胶材料会使用这类材料的连接器产品多为2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母。耐焊接温度在260度-300度左右,由于使用这种材料价格昂贵,一般是客户有特殊需求才会使用9T塑胶材料来生产连接器产品。

POM(又称赛钢、特灵)。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有的性能。POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。

新型工程塑料,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料,可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。

LCP塑胶原料的特性;

- a、LCP具有自增强性:具有异常规整的纤维状结构特点,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强,更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性,对大多数塑料存在的蠕变特点,液晶材料可以忽略不计,而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好,具有优异的阻燃性,能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高,耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃,其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀,对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水,接触后不会被溶解,也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场:电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求(能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接)。
- b、LCP:印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金(PSF/PBT/PA)作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料;作光纤电缆接头护套和高强度元件;代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料(宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统)。